

目次

概要	1
概論	1
用語の解説	2
気泡/バブル	2
コーティング ボイド	3
フィッシュアイ	3
表面絶縁抵抗 (SIR)	4
気泡の良性に関する客観的証拠の入手、試験基板を用いた実験的アプローチ	4
フィールドでの 記録	6
製造認定試験	6
J-STD-001HおよびIPC-A-610Hへの変更適用箇所	7
参考文献	8

図

図1. ベン図:電気化学的不具合に影響する変数	1
図2. ノンブリッジングバブルとブリッジングバブル(模式図)	2
図3. コンフォーマルコーティングを施したQFNに発生した気泡	2
図4. コンフォーマルコーティングを施したQFNに発生した気泡 (左側:水平方向の断面図、右側:模式図)	3
図5. フィッシュアイの断面模式図	3

表

表1: B52試験基板の気泡発生の機会:1枚(表内3列目)と10枚(同4列目)	4
---	---